

UDC 621.315.616-416 : 621.3.049.75
L 30



中华人民共和国国家标准

GB 13556—92

印制电路用挠性覆铜箔聚酯薄膜

Flexible copper-clad polyester
film for printed circuits

1992-07-08 发布

1993-04-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

印制电路用挠性覆铜箔聚酯薄膜

GB 13556—92

Flexible copper-clad polyester film for printed circuits

本标准等效采用国际标准 IEC 249-2-8(1987)《印制电路用基材第二部分:规范,规范№8:挠性覆铜箔聚酯(PETP)薄膜》。

1 主题内容和适用范围

本标准规定了印制电路用挠性覆铜箔聚酯(聚对苯二甲酸乙二酯)薄膜的各项性能要求。

本标准适用于印制电路用挠性覆铜箔聚酯薄膜,其型号为 CPETP-111。

本标准规定有“供选用”的技术要求,这些要求只有在供需双方同意的情况下才适用。在没有要求的情况下,满足所有未注明“供选用”字样的技术要求,则认为符合本标准。

2 引用标准

- GB 4721 印制电路用覆铜箔层压板通用规则
- GB 4722 印制电路用覆铜箔层压板试验方法
- GB 5230 电解铜箔
- GB/T 13557 印制电路用挠性覆铜箔材料试验方法

3 材料和组成

本材料由挠性聚酯薄膜绝缘基材,一面或二面覆以铜箔构成,可用或不用粘结剂。

3.1 绝缘基材

3.1.1 聚酯薄膜

聚酯薄膜的推荐厚度和极限偏差应符合表 1,在供需双方同意时也可以采用其他厚度。

表 1 聚酯薄膜的推荐厚度和极限偏差

标称厚度, μm	任意点极限偏差, %
12.5	±15
23	
36	
50	
75	
100	
125	

3.1.2 粘合剂

在聚酯薄膜和铜箔之间可以使用一层粘合剂。

国家技术监督局 1992-07-08 批准

1993-04-01 实施